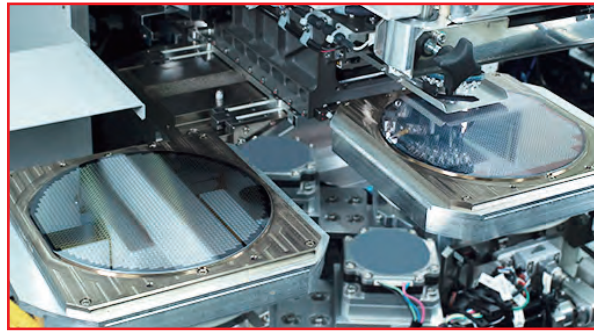
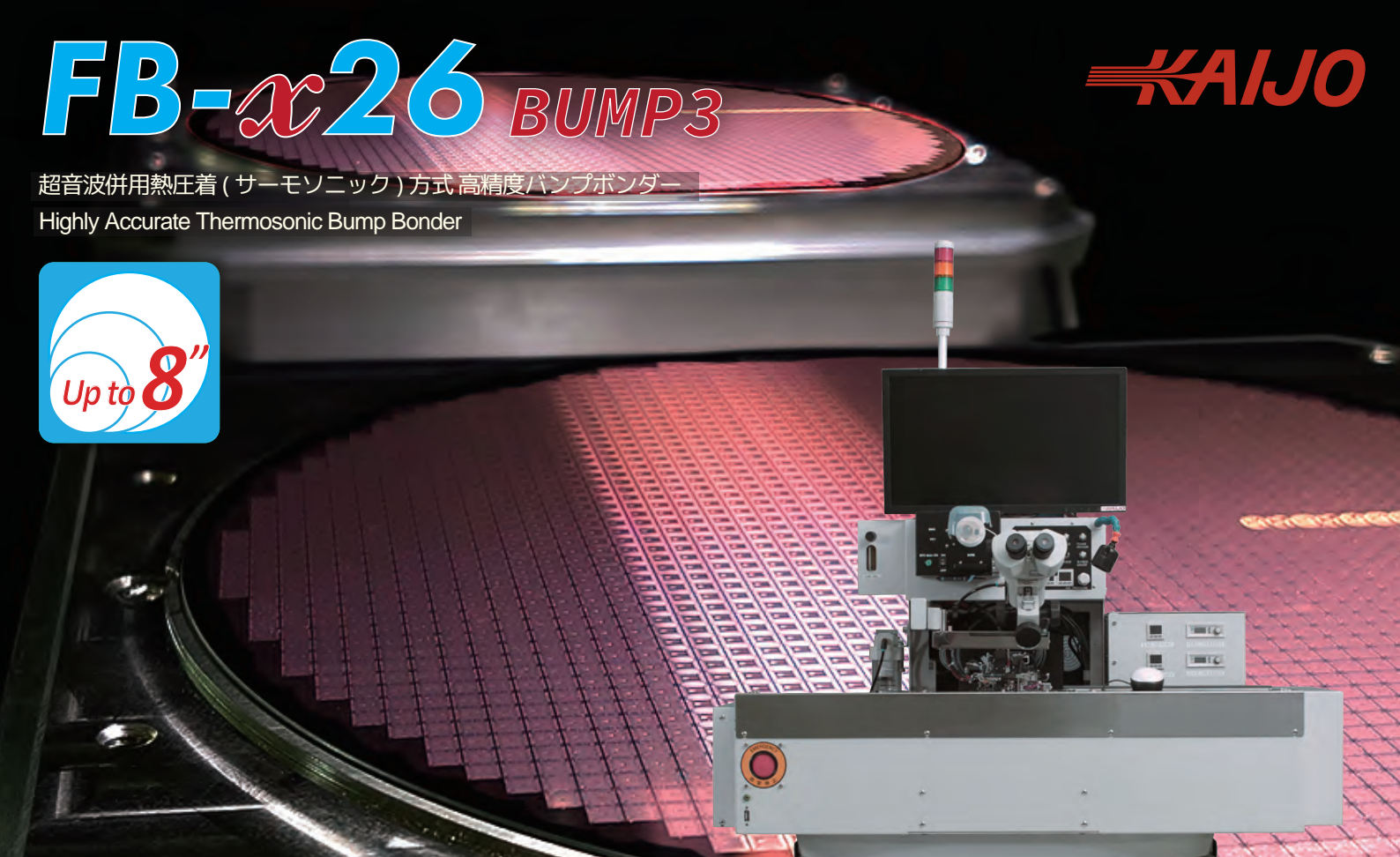


FB-x26 BUMP3

KAIJO

超音波併用熱圧着 (サーモソニック) 方式 高精度バンパボンダー

Highly Accurate Thermosonic Bump Bonder



生産性を向上させる 2 ステージ機構
2 stage mechanism improves the productivity



特長 / FEATURES

- 2つのウェハステージにより、ウェハ破損を防ぐために必要だった除熱待ち時間を解消 生産性が飛躍的にアップ
2 stages eliminate cooling time required to prevent wafer damage - Productivity has greatly improved
- トレーサビリティと自己診断機能をアップグレード 品質管理と健全な装置状態の維持が容易に
Enhanced traceability and self-diagnosis function. Contribute to quality control and machine maintenance
- 高まるコネクティビティと Industry4.0 への需要に対応
SECS/GEM 標準対応 カイジョー独自のホスト管理システム "KISS" も選択可能
Ready for the growing demand of connectivity and Industry4.0 - SECS/GEM or "KISS" (Selectable)
- ウェハ供給 WHS-996 との組み合わせで、自動搬送も可能 (別売ユニット)
Automatic wafer feeding is available in combination with a WHS-996 (Sold separately)



FB-x26 BUMP3

■ 主な仕様

ボンディング性能	
ボンディング方式	超音波併用熱圧着（サーモソニック）方式
超音波発振方式	PLLによる発振周波数自動追尾、単周波
ボンディング範囲	200mm（8インチ）まで（手載せ仕様） 自動搬送仕様はウエハ外周 2.5mm がボンディング範囲外 例）8インチ：直径 195mm の円周がボンディング範囲
繰り返し位置精度	3σ ≤ 3.0μm*
ボンディング速度	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**
画像認識機能	
認識方式	形状認識方式（α-eyes）と多値化相関処理方式から選択可
検出速度	約 100msec/2点（5mm 角チップ） 約 200msec/4点（5mm 角チップ）
検出率	99.9% 以上 **
対応ワーク	
ウエハサイズ	8インチまで 厚さ： 0.2 ~ 0.5mm
外部通信機能	
	SECS / GEM 標準対応 KISS*** 標準対応 （ホストソフトウェアはオプション）
ユーティリティ	
電源	単相 AC200V±5%, 50Hz/60Hz, 8A ※210V, 220V, 230V, 240V, 100V はオプション 最大消費電力：約 2.0kW
エア	圧力：0.3 ~ 0.970MPa（3 ~ 9.9Kgf/cm ² ）、ISO クラス5以上 消費量：40Liters/min 以下
真空	圧力：-53.32MPa 以下（400mm/Hg 以上）
装置諸元	
寸法	幅：1,132mm 奥行：1,234mm 高さ：1,728mm（警告灯上部までは 2,030mm）
重量	約 600kg

*セルフティーチ精度を除く。

**当社所定の条件下での算出値

*** Kaijo Interconnecting Service System の略称

■ SPECIFICATIONS

Bondability	
Bonding method	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation system	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Bonding area	Up to 200mm (8 ") (Manual transfer specification) In case of automatic transfer specification, wafer circumference 2.5 mm become a non-bondable area. e.g. Bonding range of 8" wafer is diameter 195mm
Bonding Accuracy	3σ ≤ 3.0μm*
Bonding Time	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**
Recognition System	
Recognition method	Shape recognition (α-eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Recognition time	Approx. 100msec/2 points (5mm square chip) Approx. 200msec/4 points (5mm square chip)
Detection rate	99.9% or more**
Applicable work size	
Wafer size	Up to 8" Thickness: 0.2 ~ 0.5mm
External interface	
	SECS / GEM available as standard KISS *** available as standard (Host software are option)
Utility	
Power	Single phase AC200V±5%, 50Hz/60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V, 100V option) Maximum power consumption : Approximately 2.0kW
Dry air	Pressure : 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption : 40Liters/min or less
Vacuum	Pressure : -53.32MPa or less (400mm/Hg or more)
Dimensions	
Width Depth Height	1,132mm 1,234mm 1,728mm (To top of signal lamp : 2,030mm)
Weight	Approx. 600kg

* Excluding self-teach accuracy.

** Calculated value under the conditions specified by KAIJO.

*** Kaijo Interconnecting Service System



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION

東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607

3-1-5 Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 2058607

URL <https://www.kaijo.co.jp>

ボンダー事業部

TEL. 042-555-6162

FAX. 042-579-5175

✉ bonder-info@kaijo.co.jp

● 国内営業（東日本）/ Domestic Sales (Tokyo)

● 国内営業（西日本）/ Domestic Sales (Osaka)

● 海外営業 / Overseas Sales

● カスタマーサポート・ヘルプデスク / Customer Support Help-desk

● 台湾海上希歩洋股份有限公司 / TAIWAN KAIJO SHIBUYA CORPORATION

● 上海楷捷半导体科技有限公司 / KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.,LTD.

● KAIJO SHIBUYA EUROPE GmbH (GERMANY)

● シブヤカイジョー（タイランド）/ SHIBUYA KAIJO(THAILAND) CO.,LTD.

● シブヤカイジョー（マレーシア）/ SHIBUYA KAIJO(MALAYSIA) SDN. BHD.

TEL.042-555-8889

TEL.06-4805-0231

TEL.042-555-0321 / +81-42-555-0321

TEL.042-555-4834 / +81-42-555-4834

TEL.+886-2-8712-2377

TEL.+86-21-6275-1515

TEL.+49-611-72429155

TEL.+66(0)2673-9496-8

TEL.+60(0)4-611-6040 (PENANG Office)

ご用命は